ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 621.315.592

ГЕНЕРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СЛОЕ СТРУКТУР Ge—GeO, ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Аг⁺

П. К. Кашкаров, А. В. Колесников, А. В. Петров, И. Г. Стоянова

(кафедра общей физики для химического факультета)

Установлено, что имплантация нонов Ar^+ в пленку GeO₂ на поверхности Ge сопровождается генерацией ловушек для дырок в слое торможения ионов и ловушек для электронов в слое GeO₂ вблизи границы с Ge, что проявляется в увеличении нестабильности заряда поверхности при освещении.

Ионное легирование поверхностных слоев полупроводников широко используется в полупроводниковой технологии. Имплантация, как правило, осуществляется либо сквозь тоякий слой естественного оксида, либо сквозь специально сформированный диэлектрический слой. При этом в поверхностной диэлектрической пленке могут возникать ловушки носителей заряда, что проявляется в зарядовой нестабильности полупроводниковых приборов. В настоящей работе изучено влияние ионной бомбардировки на спектр ловушек в оксидном слое на поверхности германия. Свойства центров захвата носителей заряда в поверхностной пленке GeO₂ необлученных образцов подробно исследованы в работах [1, 2]. Изучались структуры Ge-GeO₂, полученные термическим (толщина оксида d=

Изучались структуры Ge—GeO₂, полученные термическим (толщина оксида $d = -5 \div 90$ нм) иля анодным ($d = 100 \div 200$ нм) окислением поверхности (Ц1) высокоомных ($\rho = 25 \div 40$ Ом·см) монокристаллов *n*—Ge с размерами 0,05×0,5×1 см. Имплантация производилась при 300 К ионами Ar⁺ с энергией 20 кзВ при дозе 10¹⁵ ион/см³ в одну большую грань образца, вторая грань являлась контрольной. Изменения в системе ловушек оксида регистрировались методом оптического заряжения (O3) аналогично [1, 2]. Накопление заряда в оксиде при освещении фиксировалось методом контактной разности потенциалов. Знак контактной разности нотенциалов ΔU соответствовал знаку накапливаемого в GeO₂ заряда [3]. Все измерения проводились в вакууме 10⁻⁴ Па.

Для понимания представленных ниже экспериментальных данных необходимо сделать следующее замечание. В использованном в работе методе ОЗ фиксируется изменение заряда в оксиде при освещении образца квантами определенной энергии, причем величина этого изменения зависит от исходного заряда ловушек. Очевидно, в результате ионного облучения некоторые из возникающих в GeO₂ дефектов могут оказаться изначально заряженными, кроме того, указанное воздействие ведет к перезарядке части имевшихся ранее ловушек. Для стандартизации условий измерения часть как исходных, так и облученных образцов прогревалась при 570 К. Известно, что такая термообработка ведет к равновесному заполнению как электронных, так и дырочных ловушек в GeO₂ [1]. Отметим, что при этом возможен и отжиг части возникших при ионной бомбардировке дефектов. Поэтому для сравнения будут приведены данные для непрогретых образцов.

В соответствии с [4] длина среднего проецированного пробега ионов Ar⁺ в GeO₂ при энергии 20 кэВ равна $\overline{\Delta x} = 12 \pm 5$ им. Рассмотрим сначала случай, когда $\overline{\Delta x} \ll d$ и ноны не достигают границы раздела полупроводник — оксид. Так, на рисунке, а приведены спектры O3 для образца с d=90 им. В результате ионного облучения структур растет отрицательное O3 (ср. кривые 1 и 2). Ответственные за этот эффект электронные ловушки оказываются весьма устойчивыми, и значительная их часть не отжигается при 570 К. Более того, снижение отрицательного заряжения в результате прогрева как контрольных (кривые 1, 3), так и облученных (кривые 2, 4) структур было пропорциональным, что свидетельствует об аналогичной природе биографических и радиационных дефектов, нграющих роль центров захвата электронов в GeO₂. В необлученных структурах Ge—GeO₂ отрицательное заряжение обычно связывают с присутствием фрагментов воды в оксиде [1, 2]. Аналогичные данные получены и на структурах с более толстыми оксидами ($d=100 \div 200$ нм).

При облучении нонами аргона образцов с $d \leq \Delta x$ картина оказалась более сложной (рисунок, б). На непрогретых структурах радиационное воздействие приводило к инверсии знака ОЗ: исходное отрицательное ОЗ сменялось положительным (ср. кри-

вые 1 и 2). Этот эффект нельзя связать с наблюдаемым изменением встроенного заряда диэлектрика в результате имплантации, поскольку ионное облучение сопровождалось положительным заряжением GeO₂, соответственно роль электрического поля указанного заряда сводилась к частичному подавлению процесса инжекции зарядов положительного энака из Ge в GeO₂ при освещении. Таким образом, в случае, когда ионы аргона достигают границы раздела Ge—GeO₂, регистрируется возникновение дефектов, являющихся ловушками для дырок. Последние обычно связывают с кислородными вакансиями в GeO₂ [5].



Спектры ОЗ на образцах Ge--GeO₂ с толщинами оксида 90 (а) и 5 нм (б): исходные (1), после имплантации нонов Ar+ (2), а также после прогрева при 570 К контрольных (3) и имплантированных (4) структур

В результате термообработки при 570 К соотношение между спектрами ОЗ исходных и облученных образцов изменяется на обратное (ср. кривые 3 и 4). Как и для образцов с более толстыми оксидами, в результате воздействия ионного пучка фиксировался значительный рост отрицательного заряжения. Отсюда следует, что раднационные дефекты, играющие роль дырочных ловушек, обладают невысокой термической устойчивостью и, по-видимому, полностью отжигаются при 570 К.

Обсудим кратко возможные механизмы образования дефектов при воздействии ионов на структуру Ge-GeO2. Непосредственно в области торможения нона Ar+ возникает каскад смещенных за счет упругих столкновений атомов. Протяженность указанной области в аморфном материале определяется величинами Δx и среднего разброса пробегов [6]. На образцах с $d \leqslant \Delta x$ генерация дефектов по механизму упру-гих соударений происходит по всей толщине оксидного слоя, в том числе на границе Ge-GeO2. Так как при освещении перезаряжаются за счет фотоинжекции носителей заряда только ловушки диэлектрика, удаленные от границы раздела Ge--GeO2 не более чем на 5 нм [1], то рост положительного ОЗ в результате имплантации Art с $\Delta x \gg d$ естественно связать с возникновением кислородных вакансий в слое торможения ионов. При облучении структур с $d \gg \Delta x$ торможение нонов происходит BO внешнем слое оксида, недоступном для анализа методом ОЗ. В этом случае генерацию дефектов в диэлектрике разумно объяснить его значительным электронным возбуждением, возникающим в результате взаимодействия ионов Ar+ с атомами решетки GeO2. Такое электронное возбуждение может мигрировать в глубь оксида и распадаясь, стимулировать структурные перестройки [7], в частности образование центров захвата электронов в GeO₂.

Полученные результаты полностью согласуются с нашими данными по имплантации Ar⁺ в оксидный слой структур Si—SiO₂ [8]. Таким образом, понная имплантация в приповерхностный слой структур на основе полупроводников группы A⁴ сопровождается генерацией в поверхностном слое оксида электронных и дырочных ловушек, причем преобладание того или иного типа дефектов определяется соотношением толщины оксида и средней длины проецированного пробега ионов в нем.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Кашкаров П. К., Козлов С. Н.//Микроэлектроника. 1976. 5, № 5. С. 535. [2] Казhкагоv Р. К., Коzlov S. N., Кіselev V. F.//Suri. Sci. 1978. 75, N 1. P. 231. [3] Ефимова А. И., Ивакин Г. И., Кашкаров П. К. и др.// //Поверхность. 1988. № 9. С. 75. [4] Gibbons J. F., Johnson W. S., Муlroie S. W. Projected Range Statistics. Stroudsburg, Pennsylvania. 1975. [5] Кагуаgin S. N., Kashkarov P. K., Kiselev V. F., Коzlov S. N.//Phys. Stat. Sol. (а). 1976. 37, N 1. P. 17. [6] Мейер Д., Эриксон Л., Дэвис Д. Иоиное легирование полупроводников. М., 1973. [7] Мошовец Т. В., Холодарь Г. А., Клингер М. И. и др.//УФН. 1985. 147, № 3. С. 523. [8] Кашкаров П. К., Колесников А. В., Петров А. В.//Микроэлектроника. 1988. 17, № 6. С. 528.

> Поступила в редакцию-28.09.89

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1990. Т. 31. № 4

УДК 539.293:537.87

ЛАЗЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СВЧ-ЭНЕРГИИ В ПОЛУПРОВОДНИКЕ

А. Н. Бачурин, А. В. Козарь, С. А. Крупенко

(кафедра радиофизики)

Рассмотрено взаимодействие непрерывного СВЧ-излучения 8-мм диапазона длинволн и лазерного излучения ближней ИК-области в слое из чистого кристаллическогокремния, расположенном в прямоугольном волноводе и полностью заполняющем поперечное сечение. Предложен экспериментальный метод исследования процессов диффузии фотоносителей, времени жизни носителей заряда.

Взаимодействие электромагнитных волн СВЧ-диапазона и когерентного лазерного ИК-излучения используется в первую очередь для изучения процессов, происходящих в полупроводниках, а также для исследования их свойств в СВЧ [1] и оптических устройствах [2].

В работе рассматривается взаимодействие непрерывного СВЧ-излучения 8-мм диапазона и лазерного излучения ближней ИК-области, распространяющихся в слое из чистого кристаллического кремния вдоль кристаллографической оси (ШЧ) (образец полностью заполняет поперечное сечение волновода размерами 7,2×3,4 мм). Исследуется случай, когда на образец одновременно воздействуют оба вида из-

Исследуется случай, когда на образец одновременно воздействуют оба вида излучения, причем непрерывное СВЧ-излучение является достаточно мощным. При этом наблюдалось воздействие на физические параметры полупроводника — концентрацию N и подвижность и свободных носителей — не только температуры образца T ($N^2 = = 1,5 \cdot 10^{33} T^3 \exp(\Delta \mathscr{G}/kT)$ см⁻⁶ — квадрат концентрации иосителей в случае использования кремния с собственной проводимостью [3]) и величины мощности лазерной фотонакачки P, но и электрической составляющей E СВЧ-излучения [4], так как

$$\mu = \mu_0 \left(\frac{1}{2} + \left\{ 1 + \left[1 + \left(\frac{3\pi}{8} \right) \left(\frac{\mu_0 E}{U} \right)^2 \right]^{1/2} \right\} \right)^{-1/2},$$

где U — скорость звука в образце, $\mu_0 = 4 \cdot 10^9 T^{-2.6} \text{ см}^2 \cdot \text{B}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$ — подвижность свободных носителей заряда в слабом поле [3]. Как показано в [5, 6], коэффициенты отражения Г и поглощения А являются функциями удельной проводимости $\sigma = Ne\mu$, длины волны СВЧ-излучения λ , толщины образца d_0 , диэлектрической проницаемости ε' .

Генерация СВЧ-излучения последовательно осуществлялась на двух частотах: $f_1 = = 34,86$ ГГп и $f_2 = 36,02$ ГГп, толщина образца $d_0 = 1,35$ мм является полуволновой для: СВЧ-излучения с частотой f_1 , длина волны излучения лазера $\lambda_0 = 1,15$ мкм.

На рис. 1, а представлена теоретическая зависимость квадрата коэффициента отражения $G = |\Gamma|^2$ от частоты СВЧ-излучения f и проводимости σ (при расчетах $\sigma = -\sigma(T, E)$ использовалось эмпирическое приближение $T\{K\}=293+0,5$ P_{RF} [Br], применимое к конкретным условиям данного эксперимента). На рис. 1, δ представлена, аналогичная теоретическая зависимость коэффициента поглощения A. Рис. 1 иллюстрирует случай, когда мощность лазерной накачки P = 7,5 мВт. На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости квадрата коэффициента отражения G от мощности